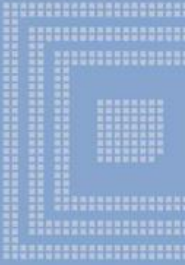




ASE GROUP



日月光半導體 2015第四季法人說明會

董宏思
財務長
日月光半導體
2016年1月29日

Safe Harbor Notice



This presentation contains "forward-looking statements" within the meaning of Section 27A of the United States Securities Act of 1933, as amended, and Section 21E of the United States Securities Exchange Act of 1934, as amended, including statements regarding our future results of operations and business prospects. Although these forward-looking statements, which may include statements regarding our future results of operations, financial condition or business prospects, are based on our own information and information from other sources we believe to be reliable, you should not place undue reliance on these forward-looking statements, which apply only as of the date of this press release. The words "anticipate," "believe," "estimate," "expect," "intend," "plan" and similar expressions, as they relate to us, are intended to identify these forward-looking statements in this press release. Our actual results of operations, financial condition or business prospects may differ materially from those expressed or implied in these forward-looking statements for a variety of reasons, including risks associated with cyclicity and market conditions in the semiconductor or electronic industry; changes in our regulatory environment, including our ability to comply with new or stricter environmental regulations and to resolve environmental liabilities; demand for the outsourced semiconductor packaging, testing and electronic manufacturing services we offer and for such outsourced services generally; the highly competitive semiconductor or manufacturing industry we are involved in; our ability to introduce new technologies in order to remain competitive; international business activities; our business strategy; our future expansion plans and capital expenditures; the strained relationship between the Republic of China and the People's Republic of China; general economic and political conditions; the recent global economic crisis; possible disruptions in commercial activities caused by natural or human-induced disasters; fluctuations in foreign currency exchange rates; and other factors. For a discussion of these risks and other factors, please see the documents we file from time to time with the Securities and Exchange Commission, including our 2014 Annual Report on Form 20-F filed on March 18, 2015.



日月光公開收購矽品股份重大事項



目前公開收購主要事項

- 日月光擬公開收購矽品精密工業股份有限公司已發行之股份（含美國存託憑證所表彰之普通股）。預定之最高收購數量為矽品公司普通股770,000,000股（含矽品公司流通在外美國存託憑證所表彰之普通股股數），約當於矽品公司已發行普通股股份總數之24.71%
- 公開收購成就條件: 1)參與應賣股份到達5%下限 (至少 155,818,056 股普通股參與台灣應賣)，2) 台灣公平會核准
- 公開收購時間將自2015年12月29號開始至2016年2月16號為止。如果公平會要求更長審核時間，此次公開收購將有可能延長至2016年3月17號
- 日月光目前已著手進行此次公開收購相關之法規核准事宜
- 日月光將會用自有現金與銀行貸款支應本次公開收購
- 日月光目前擁有矽品24.99% 之股份。如果本次公開收購成就，並且到達收購上限，日月光將會持有矽品49.71%股份

日月光公開收購矽品股份重大事項 (續)



- 日月光將透過兩階段式的交易達到最終目標之**100%現金收購矽品股份**
 - 日月光將會在(i)矽品股東於任何股東會未決議通過矽品擬與第三方辦理私募普通股案；或(ii)矽品公司終止與第三方之私募案, 依企業併購法之規定，促使矽品公司董事會通過日月光半導體與矽品公司之股份轉換案，由日月光半導體向矽品公司股東支付每股新台幣55元（每單位美國存託憑證支付新台幣275元）之對價
 - 若上述條件均成就且本次公開收購順利完成，日月光將以向矽品公司董事會提案及/或自行召集矽品公司股東臨時會之方式改選矽品公司全體董事，及/或參與矽品公司新任董事之選舉，以達成**100%收購**之目標
 - 日月光還是期望與矽品合意達成共識
 - 日月光認為收購矽品股份之交易將挹注日月光之每股盈餘，兩家公司之合作將對台灣封測產業，兩方股東及客戶之權益帶來正面效益



合併綜合損益表

與上一季比較

(未經會計師查核)



(新台幣百萬元)	Q4 / 2015	%	Q3 / 2015	%	季變化
營業收入淨額:					
封裝	29,093	38.5%	29,575	40.6%	-2%
測試	6,356	8.4%	6,426	8.8%	-1%
材料直接銷售	798	1.1%	762	1.0%	5%
電子代工服務	39,301	52.0%	36,107	49.5%	9%
其它	0	0.0%	0	0.0%	
營業收入淨額合計	75,548	100.0%	72,870	100.0%	4%
營業毛利	13,283	17.6%	12,987	17.8%	2%
營業淨利 (淨損)*	6,843	9.1%	6,382	8.8%	7%
稅前淨利 (淨損)*	6,150	8.1%	7,810	10.7%	-21%
所得稅利益 (費用)*	(1,266)	-1.7%	(1,127)	-1.5%	
非控制權益	(322)	-0.4%	(315)	-0.4%	
歸屬於本公司業主之淨利*	4,562	6.0%	6,368	8.7%	-28%
基本每股盈餘 (新台幣元)*	0.60		0.83		
稀釋每股盈餘 (新台幣元)*	0.58		0.69		
EBITDA*	14,230	18.8%	15,903	21.8%	-11%

* 標記之數字已反應矽品公司公告之2015年第四季及全年自結獲利報告。本公司於法說會公佈之版本亦附於本文件後。

合併綜合損益表

與去年同期比較

(未經會計師查核)



(新台幣百萬元)	Q4 / 2015	%	Q4 / 2014	%	年變化
營業收入淨額:					
封裝	29,093	38.5%	31,942	41.7%	-9%
測試	6,356	8.4%	6,663	8.7%	-5%
材料直接銷售	798	1.1%	861	1.1%	-7%
電子代工服務	39,301	52.0%	37,178	48.5%	6%
其它	0	0.0%	0	0.0%	
營業收入淨額合計	75,548	100.0%	76,644	100.0%	-1%
營業毛利	13,283	17.6%	16,411	21.4%	-19%
營業淨利 (淨損)*	6,843	9.1%	9,847	12.8%	-31%
稅前淨利 (淨損)*	6,150	8.1%	9,579	12.5%	-36%
所得稅利益 (費用)*	(1,266)	-1.7%	(1,475)	-1.9%	
非控制權益	(322)	-0.4%	(240)	-0.3%	
歸屬於本公司業主之淨利*	4,562	6.0%	7,864	10.3%	-42%
基本每股盈餘 (新台幣元)*	0.60		1.02		
稀釋每股盈餘 (新台幣元)*	0.58		0.99		
EBITDA*	14,230	18.8%	17,257	22.5%	-18%

* 標記之數字已反應矽品公司公告之2015年第四季及全年自結獲利報告。本公司於法說會公佈之版本亦附於本文件後。

合併綜合損益表

與去年同期比較

(未經會計師查核)



(新台幣百萬元)	全年 / 2015	%	全年 / 2014	%	年變化
營業收入淨額:					
封裝	116,607	41.2%	121,336	47.3%	-4%
測試	25,192	8.9%	25,875	10.1%	-3%
材料直接銷售	3,260	1.2%	3,546	1.4%	-8%
電子代工服務	138,242	48.8%	105,785	41.2%	31%
其它	1	0.0%	49	0.0%	-98%
營業收入淨額合計	283,302	100.0%	256,591	100.0%	10%
營業毛利	50,149	17.7%	53,589	20.9%	-6%
營業淨利 (淨損)*	24,926	8.8%	29,646	11.6%	-16%
稅前淨利 (淨損)*	24,866	8.8%	28,548	11.1%	-13%
所得稅利益 (費用)*	(4,845)	-1.7%	(4,266)	-1.7%	
非控制權益	(970)	-0.3%	(645)	-0.3%	
歸屬於本公司業主之淨利*	19,051	6.7%	23,637	9.2%	-19%
基本每股盈餘 (新台幣元)*	2.49		3.07		
稀釋每股盈餘 (新台幣元)*	2.39		2.96		
EBITDA*	56,973	20.1%	57,640	22.5%	-1%

* 標記之數字已反應矽品公司公告之2015年第四季及全年自結獲利報告。本公司於法說會公佈之版本亦附於本文件後。



綜合損益表 – 半導體封裝測試

與上一季比較

(未經會計師查核)



(新台幣百萬元)	Q4 / 2015	%	Q3 / 2015	%	季變化
營業收入淨額:					
封裝	31,121	81.0%	32,489	81.5%	-4%
測試	6,356	16.5%	6,426	16.1%	-1%
材料直接銷售	910	2.4%	928	2.3%	-2%
其它	19	0.0%	19	0.0%	0%
營業收入淨額合計	38,406	100.0%	39,862	100.0%	-4%
營業毛利	9,992	26.0%	10,651	26.7%	-6%
營業淨利 (淨損)*	5,355	13.9%	5,644	14.2%	-5%
稅前淨利 (淨損)*	5,718	14.9%	7,433	18.6%	-23%
所得稅利益 (費用)*	(1,105)	-2.9%	(1,016)	-2.5%	
非控制權益	(51)	-0.1%	(49)	-0.1%	
歸屬於本公司業主之淨利*	4,562	11.9%	6,368	16.0%	-28%
EBITDA*	12,046	31.4%	14,898	37.4%	-19%

* 標記之數字已反應矽品公司公告之2015年第四季及全年自結獲利報告。本公司於法說會公佈之版本亦附於本文件後。



綜合損益表 – 半導體封裝測試

與去年同期比較

(未經會計師查核)



(新台幣百萬元)	Q4 / 2015	%	Q4 / 2014	%	年變化
營業收入淨額:					
封裝	31,121	81.0%	36,359	82.9%	-14%
測試	6,356	16.5%	6,663	15.2%	-5%
材料直接銷售	910	2.4%	862	2.0%	6%
其它	19	0.0%	0	0.0%	
營業收入淨額合計	38,406	100.0%	43,884	100.0%	-12%
營業毛利	9,992	26.0%	13,772	31.4%	-27%
營業淨利 (淨損)*	5,355	13.9%	8,931	20.4%	-40%
稅前淨利 (淨損)*	5,718	14.9%	9,273	21.1%	-38%
所得稅利益 (費用)*	(1,105)	-2.9%	(1,344)	-3.1%	
非控制權益	(51)	-0.1%	(65)	-0.1%	
歸屬於本公司業主之淨利*	4,562	11.9%	7,864	17.9%	-42%
EBITDA*	12,046	31.4%	15,801	36.0%	-24%

* 標記之數字已反應矽品公司公告之2015年第四季及全年自結獲利報告。本公司於法說會公佈之版本亦附於本文件後。

綜合損益表 – 半導體封裝測試

與去年同期比較

(未經會計師查核)



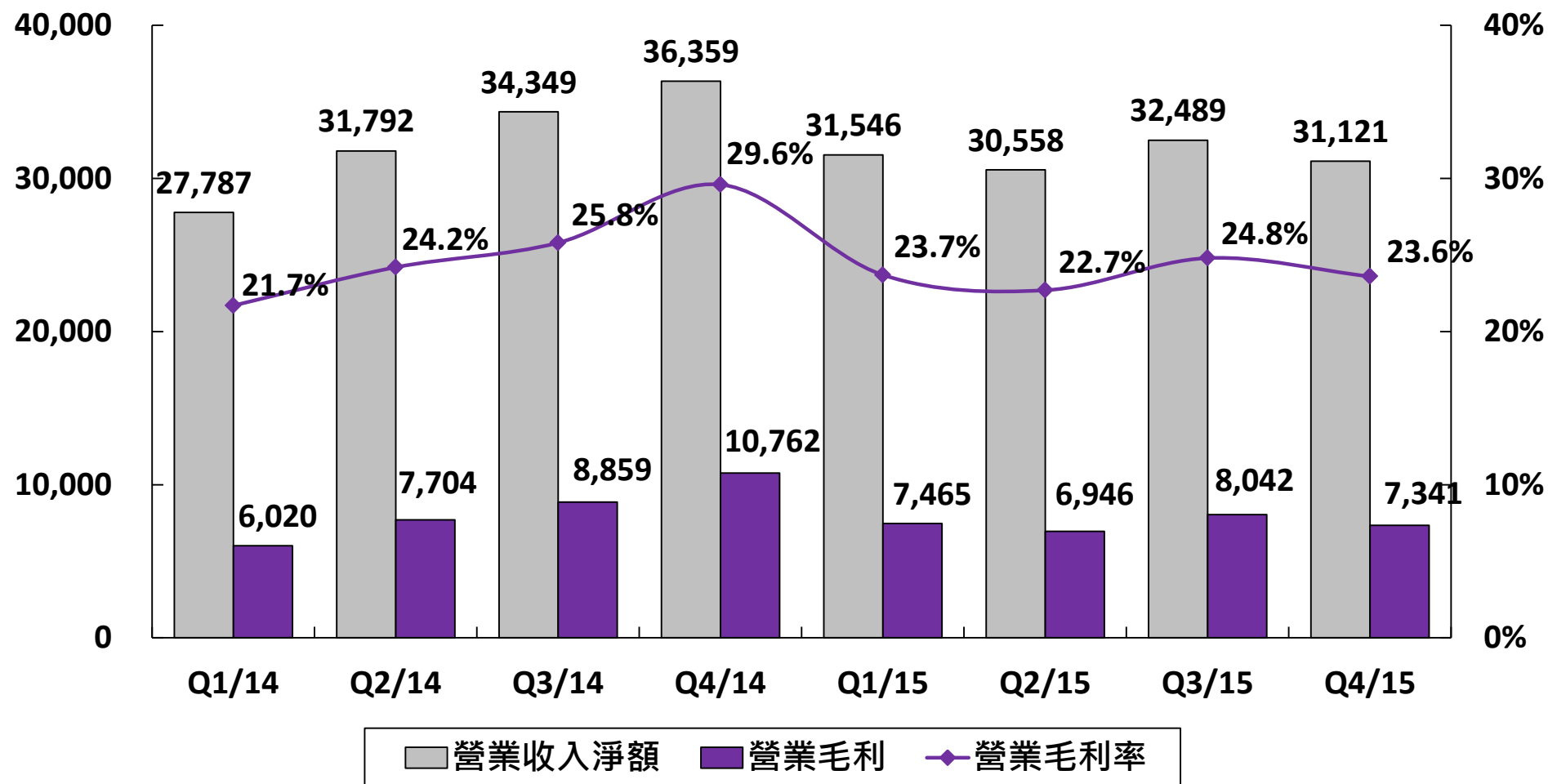
(新台幣百萬元)	全年 / 2015	%	全年 / 2014	%	年變化
營業收入淨額:					
封裝	125,714	81.3%	130,287	81.6%	-4%
測試	25,192	16.3%	25,875	16.2%	-3%
材料直接銷售	3,564	2.3%	3,550	2.2%	0%
其它	74	0.0%	0	0.0%	
營業收入淨額合計	154,544	100.0%	159,712	100.0%	-3%
營業毛利	40,142	26.0%	44,706	28.0%	-10%
營業淨利 (淨損)*	21,646	14.0%	26,500	16.6%	-18%
稅前淨利 (淨損)*	23,610	15.3%	27,501	17.2%	-14%
所得稅利益 (費用)*	(4,367)	-2.8%	(3,675)	-2.3%	
非控制權益	(192)	-0.1%	(189)	-0.1%	
歸屬於本公司業主之淨利*	19,051	12.3%	23,637	14.8%	-19%
EBITDA*	50,501	32.7%	52,790	33.1%	-4%

* 標記之數字已反應矽品公司公告之2015年第四季及全年自結獲利報告。本公司於法說會公佈之版本亦附於本文件後。



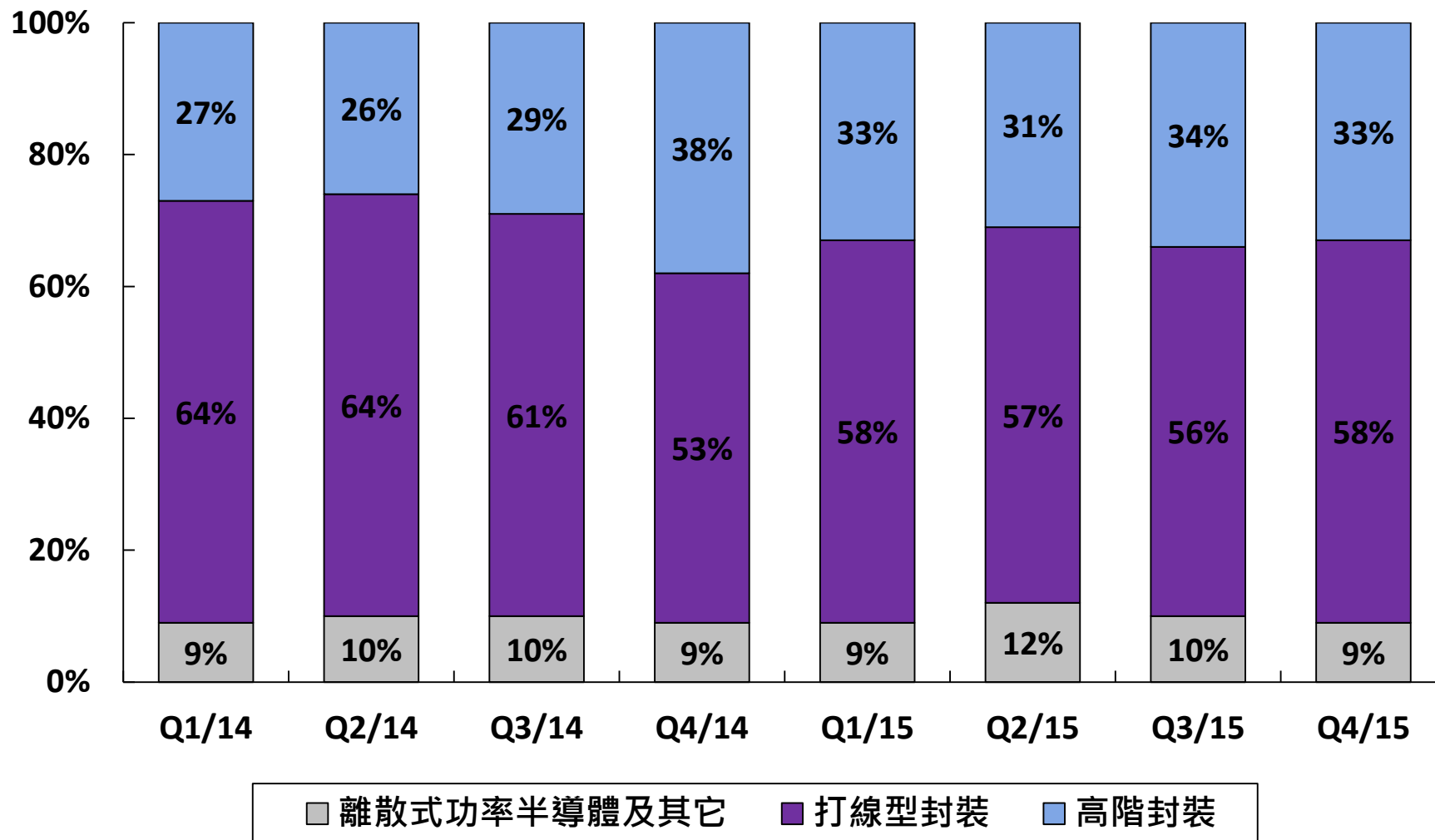
封裝業務

新台幣百萬元



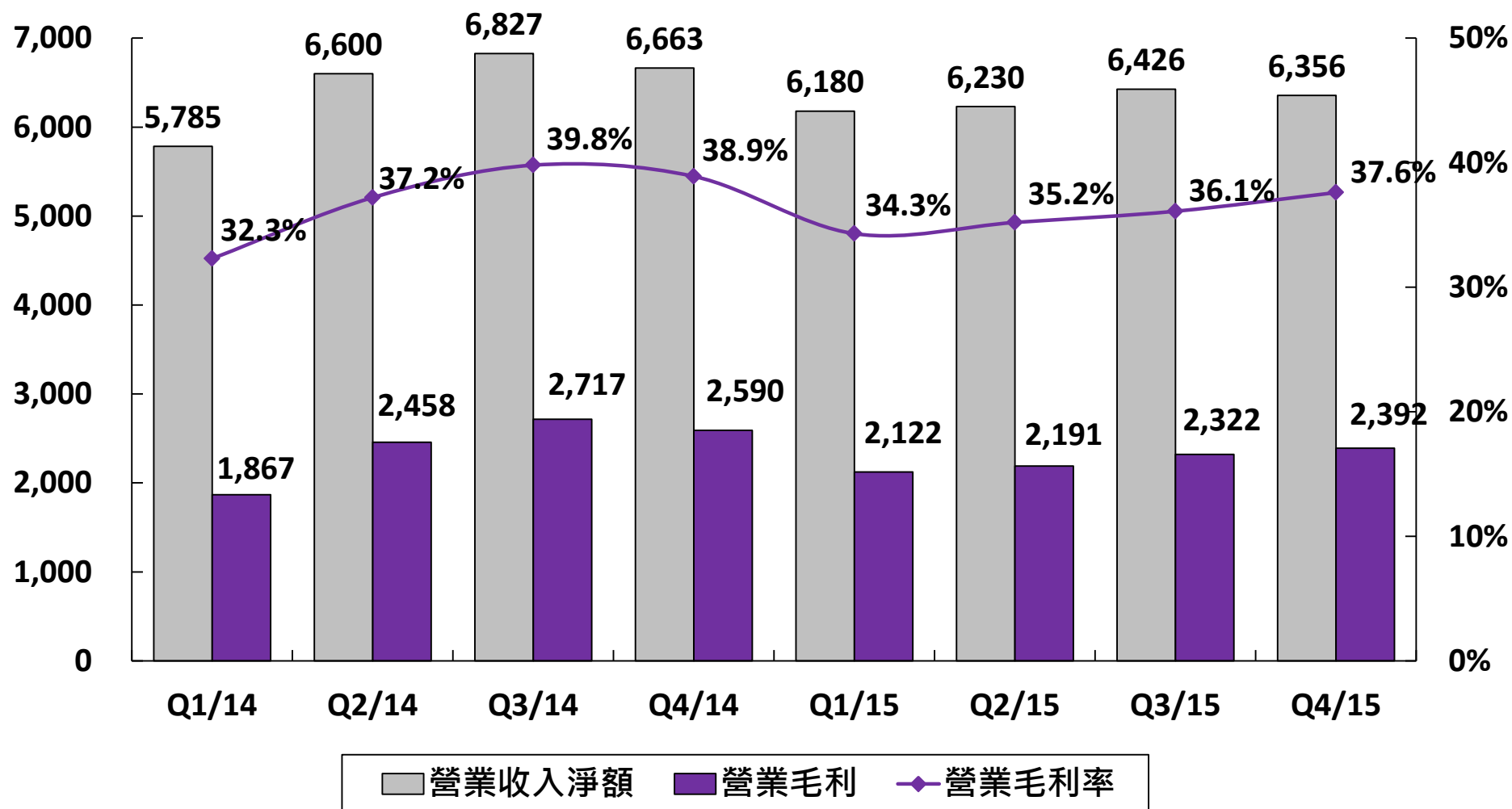
封裝業務

產品組合



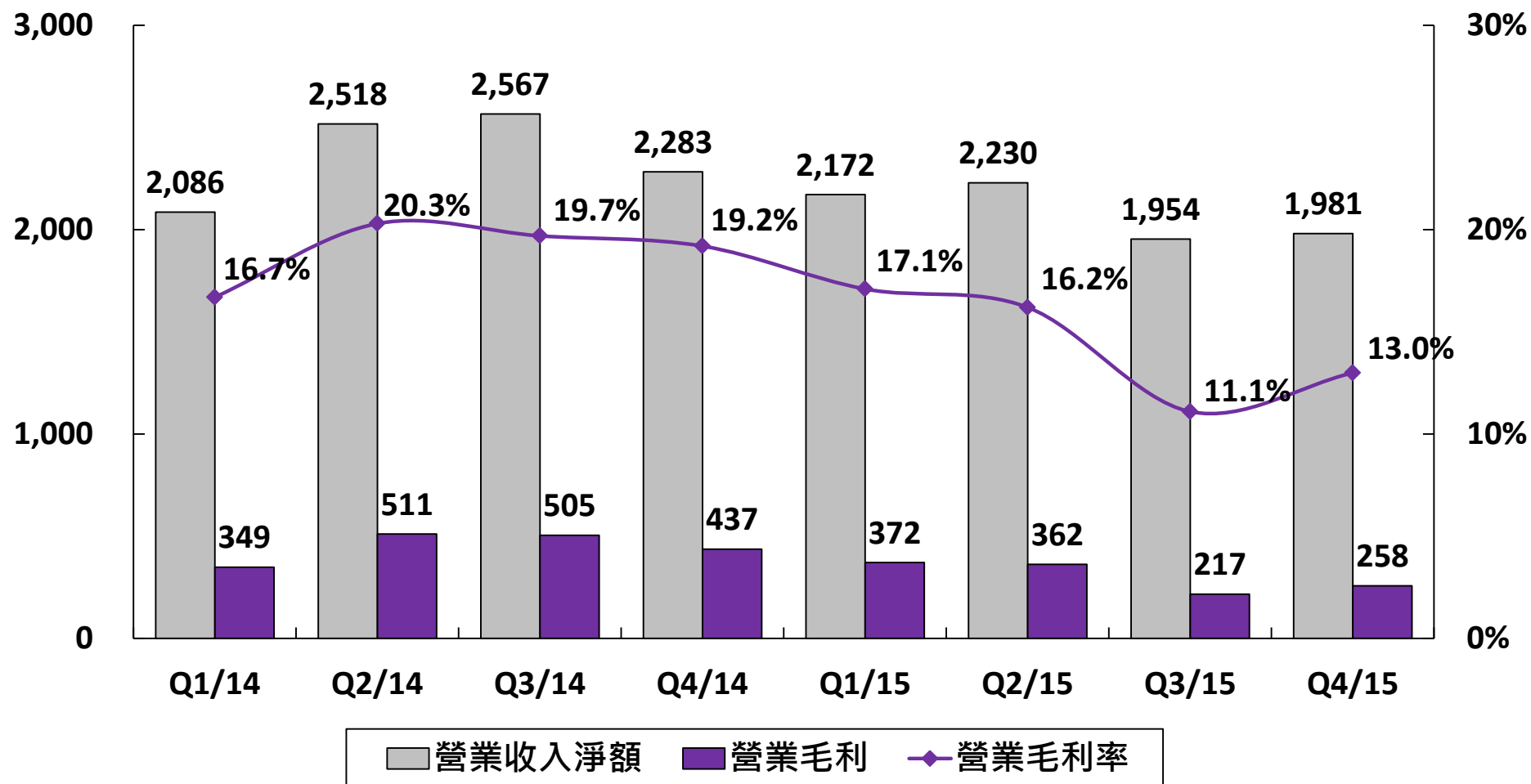
測試業務

新台幣百萬元



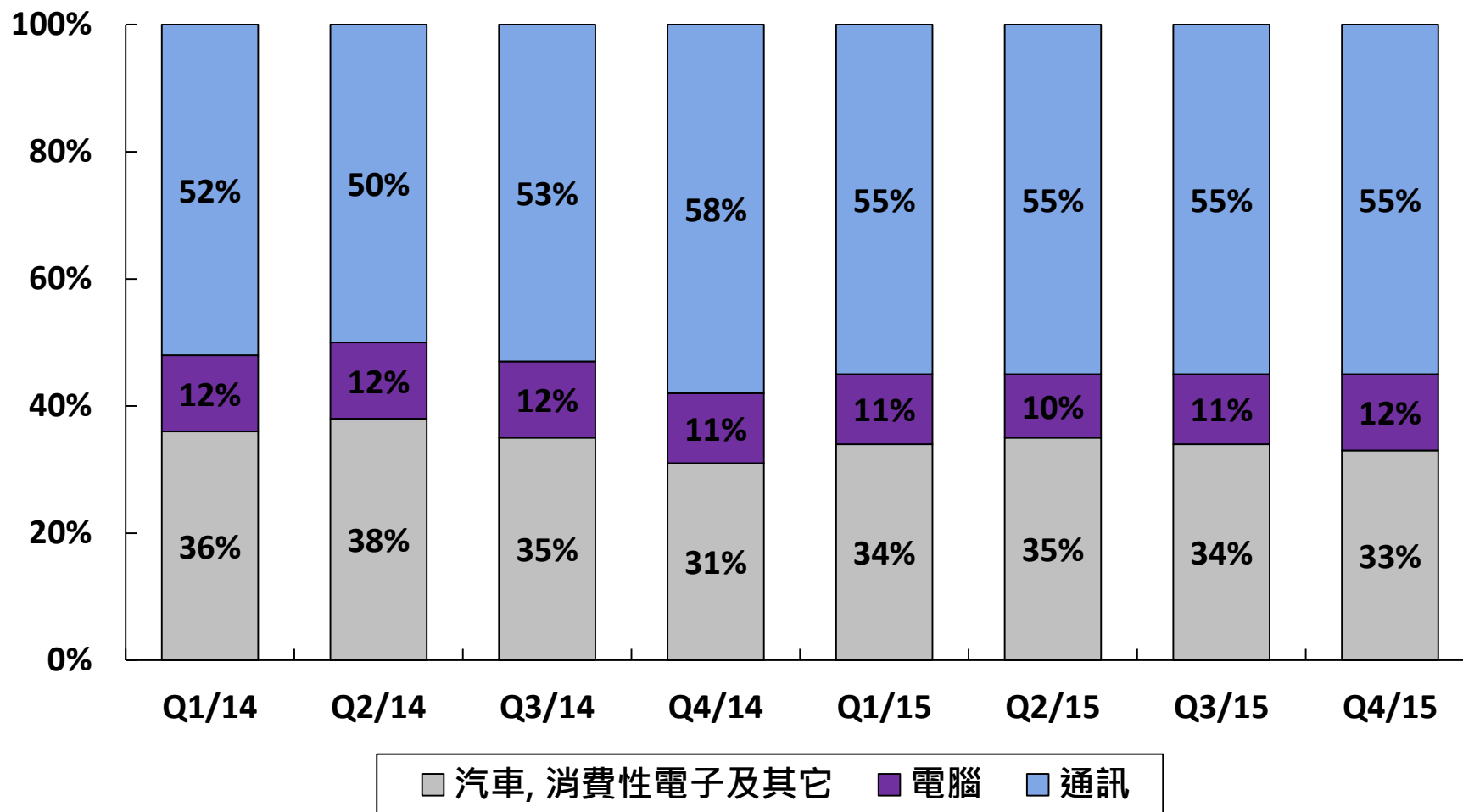
材料業務

新台幣百萬元



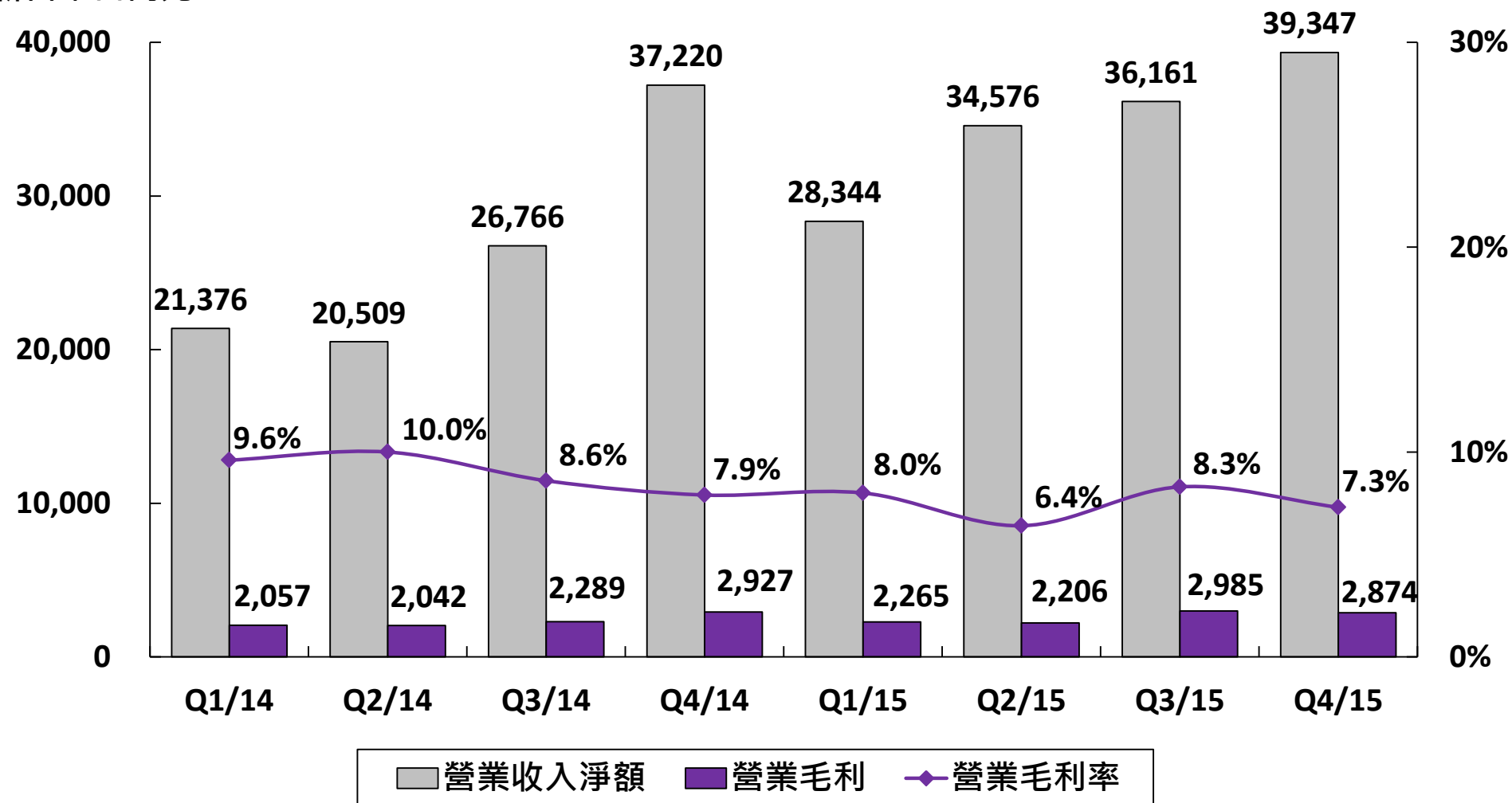
半導體封測營收

產品應用別佔比



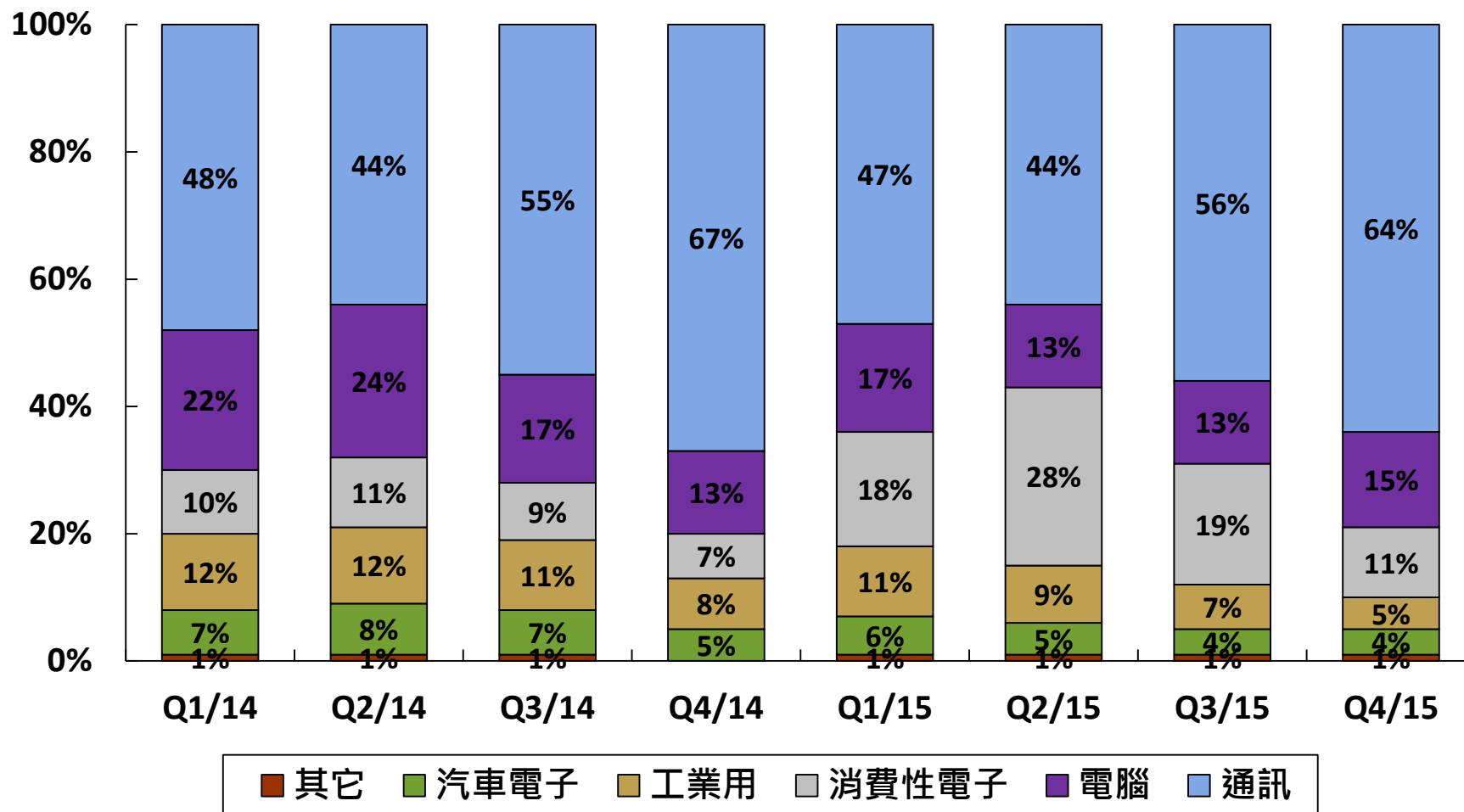
電子代工服務業務

新台幣百萬元



電子代工服務業務

產品應用別



重要資產負債表項目及財務指標

(未經會計師查核)



ASE GROUP

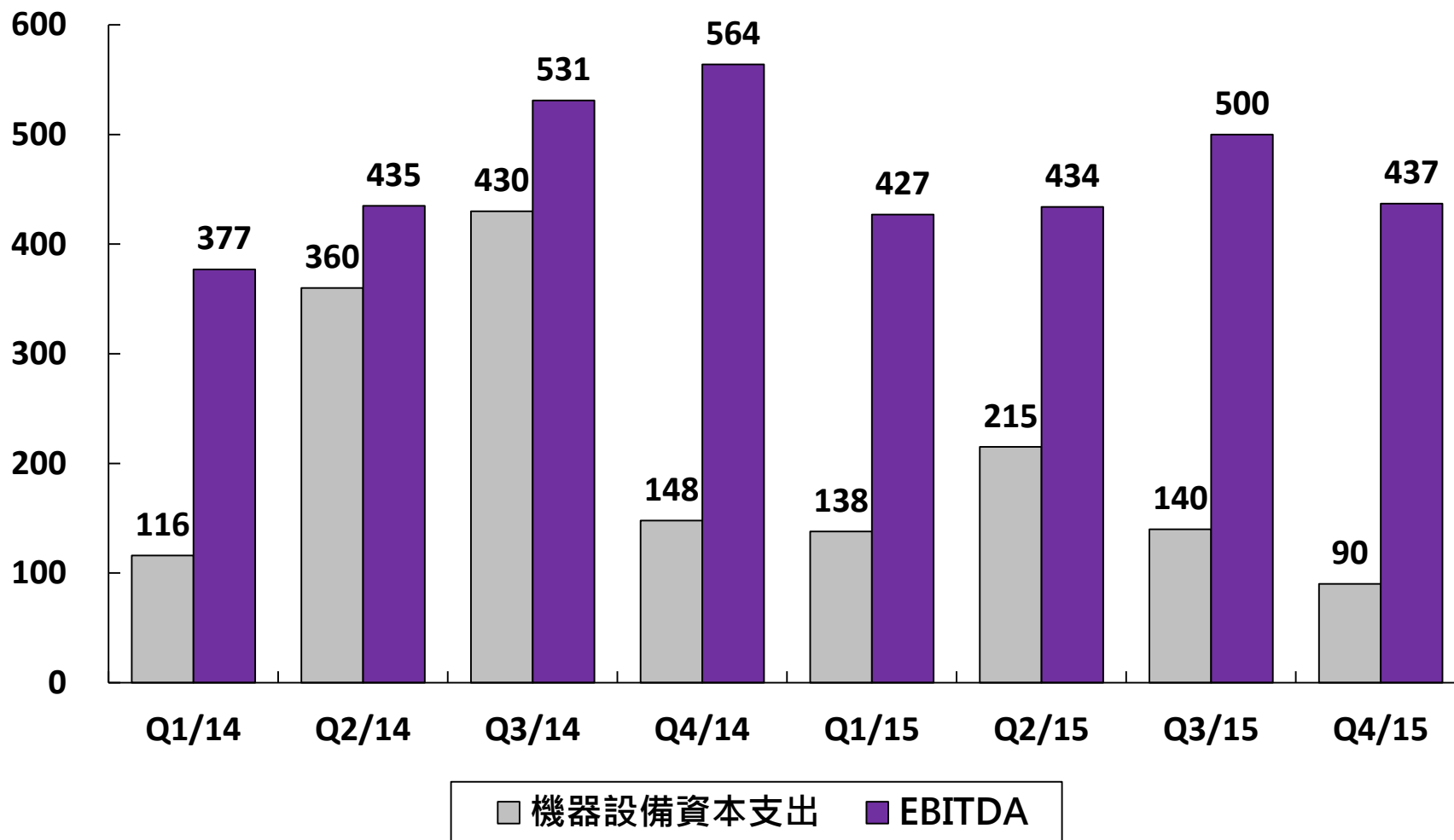
(新台幣百萬元)	2015年12月31日	2015年9月30日	季變化
現金及約當現金	55,251	42,410	30.3%
金融資產 - 流動	3,864	3,158	22.4%
金融資產 - 非流動及採用權益法之投資*	38,320	37,887	1.1%
不動產、廠房及設備	149,997	152,981	-2.0%
資產總計*	365,260	368,452	-0.9%
短期借款	36,983	45,747	-19.2%
一年內到期之應付公司債	14,686	2,578	469.7%
一年內到期之長期借款及應付租賃款	2,157	2,028	6.4%
應付公司債	23,740	35,804	-33.7%
長期借款及應付租賃款	42,795	38,389	11.5%
權益總計 (含非控制權益)*	168,428	164,283	2.5%
當季 EBITDA*	14,230	15,903	-10.5%
流動比率	1.30	1.31	
負債權益比率	0.36	0.48	

* 標記之數字已反應矽品公司公告之2015年第四季及全年自結獲利報告。本公司於法說會公佈之版本亦附於本文件後。



機器設備資本支出及EBITDA

美金百萬元



2016年第一季業績展望



根據對當前業務狀況的評估及匯率的假設，日月光公司2016年第一季的業績展望如下：

- 半導體封測事業之產能持平而產能利用率將較上季下滑高個位數百分比；
- 半導體封測事業之毛利率應與1Q14水準相近；
- 電子代工服務生意量將會略低於去年同期水準；
- 電子代工服務毛利率應較上季小幅下滑。



Thank You

www.aseglobal.com
ir@aseglobal.com



合併綜合損益表

與上一季比較

(未經會計師查核)

法說會公佈版本



(新台幣百萬元)

營業收入淨額:

	Q4 / 2015	%	Q3 / 2015	%	季變化
封裝	29,093	38.5%	29,575	40.6%	-2%
測試	6,356	8.4%	6,426	8.8%	-1%
材料直接銷售	798	1.1%	762	1.0%	5%
電子代工服務	39,301	52.0%	36,107	49.5%	9%
其它	0	0.0%	0	0.0%	
營業收入淨額合計	75,548	100.0%	72,870	100.0%	4%
營業毛利	13,283	17.6%	12,987	17.8%	2%
營業淨利 (淨損)	6,829	9.0%	6,382	8.8%	7%
稅前淨利 (淨損)	6,289	8.3%	7,810	10.7%	-19%
所得稅利益 (費用)	(1,264)	-1.7%	(1,127)	-1.5%	
非控制權益	(322)	-0.4%	(315)	-0.4%	
歸屬於本公司業主之淨利	4,703	6.2%	6,368	8.7%	-26%
基本每股盈餘 (新台幣元)	0.62		0.83		
稀釋每股盈餘 (新台幣元)	0.60		0.69		
EBITDA	14,217	18.8%	15,903	21.8%	-11%

合併綜合損益表

與去年同期比較

(未經會計師查核)

法說會公佈版本



(新台幣百萬元)

營業收入淨額:

	Q4 / 2015	%	Q4 / 2014	%	年變化
封裝	29,093	38.5%	31,942	41.7%	-9%
測試	6,356	8.4%	6,663	8.7%	-5%
材料直接銷售	798	1.1%	861	1.1%	-7%
電子代工服務	39,301	52.0%	37,178	48.5%	6%
其它	0	0.0%	0	0.0%	
營業收入淨額合計	75,548	100.0%	76,644	100.0%	-1%
營業毛利	13,283	17.6%	16,411	21.4%	-19%
營業淨利 (淨損)	6,829	9.0%	9,847	12.8%	-31%
稅前淨利 (淨損)	6,289	8.3%	9,579	12.5%	-34%
所得稅利益 (費用)	(1,264)	-1.7%	(1,475)	-1.9%	
非控制權益	(322)	-0.4%	(240)	-0.3%	
歸屬於本公司業主之淨利	4,703	6.2%	7,864	10.3%	-40%
基本每股盈餘 (新台幣元)	0.62		1.02		
稀釋每股盈餘 (新台幣元)	0.60		0.99		
EBITDA	14,217	18.8%	17,257	22.5%	-18%

合併綜合損益表

與去年同期比較

(未經會計師查核)

法說會公佈版本



(新台幣百萬元)	全年 / 2015	%	全年 / 2014	%	年變化
營業收入淨額:					
封裝	116,607	41.2%	121,336	47.3%	-4%
測試	25,192	8.9%	25,875	10.1%	-3%
材料直接銷售	3,260	1.2%	3,546	1.4%	-8%
電子代工服務	138,242	48.8%	105,785	41.2%	31%
其它	1	0.0%	49	0.0%	-98%
營業收入淨額合計	283,302	100.0%	256,591	100.0%	10%
營業毛利	50,149	17.7%	53,589	20.9%	-6%
營業淨利 (淨損)	24,912	8.8%	29,646	11.6%	-16%
稅前淨利 (淨損)	25,005	8.8%	28,548	11.1%	-12%
所得稅利益 (費用)	(4,843)	-1.7%	(4,266)	-1.7%	
非控制權益	(970)	-0.3%	(645)	-0.3%	
歸屬於本公司業主之淨利	19,192	6.8%	23,637	9.2%	-19%
基本每股盈餘 (新台幣元)	2.51		3.07		
稀釋每股盈餘 (新台幣元)	2.41		2.96		
EBITDA	56,959	20.1%	57,640	22.5%	-1%

綜合損益表 – 半導體封裝測試

與上一季比較

(未經會計師查核)

法說會公佈版本



(新台幣百萬元)	Q4 / 2015	%	Q3 / 2015	%	季變化
營業收入淨額:					
封裝	31,121	81.0%	32,489	81.5%	-4%
測試	6,356	16.5%	6,426	16.1%	-1%
材料直接銷售	910	2.4%	928	2.3%	-2%
其它	19	0.0%	19	0.0%	0%
營業收入淨額合計	38,406	100.0%	39,862	100.0%	-4%
營業毛利	9,992	26.0%	10,651	26.7%	-6%
營業淨利 (淨損)	5,341	13.9%	5,644	14.2%	-5%
稅前淨利 (淨損)	5,857	15.3%	7,433	18.6%	-21%
所得稅利益 (費用)	(1,103)	-2.9%	(1,016)	-2.5%	
非控制權益	(51)	-0.1%	(49)	-0.1%	
歸屬於本公司業主之淨利	4,703	12.2%	6,368	16.0%	-26%
EBITDA	12,033	31.3%	14,898	37.4%	-19%

綜合損益表 – 半導體封裝測試

與去年同期比較

(未經會計師查核)

法說會公佈版本



(新台幣百萬元)	Q4 / 2015	%	Q4 / 2014	%	年變化
營業收入淨額:					
封裝	31,121	81.0%	36,359	82.9%	-14%
測試	6,356	16.5%	6,663	15.2%	-5%
材料直接銷售	910	2.4%	862	2.0%	6%
其它	19	0.0%	0	0.0%	
營業收入淨額合計	38,406	100.0%	43,884	100.0%	-12%
營業毛利	9,992	26.0%	13,772	31.4%	-27%
營業淨利 (淨損)	5,341	13.9%	8,931	20.4%	-40%
稅前淨利 (淨損)	5,857	15.3%	9,273	21.1%	-37%
所得稅利益 (費用)	(1,103)	-2.9%	(1,344)	-3.1%	
非控制權益	(51)	-0.1%	(65)	-0.1%	
歸屬於本公司業主之淨利	4,703	12.2%	7,864	17.9%	-40%
EBITDA	12,033	31.3%	15,801	36.0%	-24%



綜合損益表 – 半導體封裝測試

與去年同期比較

(未經會計師查核)

法說會公佈版本



(新台幣百萬元)	全年 / 2015	%	全年 / 2014	%	年變化
營業收入淨額:					
封裝	125,714	81.3%	130,287	81.6%	-4%
測試	25,192	16.3%	25,875	16.2%	-3%
材料直接銷售	3,564	2.3%	3,550	2.2%	0%
其它	74	0.0%	0	0.0%	
營業收入淨額合計	154,544	100.0%	159,712	100.0%	-3%
營業毛利	40,142	26.0%	44,706	28.0%	-10%
營業淨利 (淨損)	21,632	14.0%	26,500	16.6%	-18%
稅前淨利 (淨損)	23,749	15.4%	27,501	17.2%	-14%
所得稅利益 (費用)	(4,365)	-2.8%	(3,675)	-2.3%	
非控制權益	(192)	-0.1%	(189)	-0.1%	
歸屬於本公司業主之淨利	19,192	12.4%	23,637	14.8%	-19%
EBITDA	50,487	32.7%	52,790	33.1%	-4%



重要資產負債表項目及財務指標

(未經會計師查核)

法說會公佈版本



ASE GROUP

(新台幣百萬元)	2015年12月31日	2015年9月30日	季變化
現金及約當現金	55,251	42,410	30.3%
金融資產 - 流動	3,864	3,158	22.4%
金融資產 - 非流動及採用權益法之投資	38,079	37,887	0.5%
不動產、廠房及設備	149,997	152,981	-2.0%
資產總計	365,019	368,452	-0.9%
短期借款	36,983	45,747	-19.2%
一年內到期之應付公司債	14,686	2,578	469.7%
一年內到期之長期借款及應付租賃款	2,157	2,028	6.4%
應付公司債	23,740	35,804	-33.7%
長期借款及應付租賃款	42,795	38,389	11.5%
權益總計 (含非控制權益)	168,175	164,283	2.4%
當季 EBITDA	14,217	15,903	-10.6%
流動比率	1.30	1.31	
負債權益比率	0.36	0.48	

